



PART NO. : TG111-S212NWRL

50PIN 0.040" LEAD PITCH SMT PACKAGE

DESIGNED FOR DUAL-PORT GIGABIT, IEEE802.3ab OR FOUR-PORT FAST ETHERNET, IEEE802.3u APPLICATIONS

COMPLIANT WITH IEEE802.3af REQUIREMENTS WITH 350mA CURRENT CARRYING CAPACITY FOR PoE

RoHS COMPLIANT

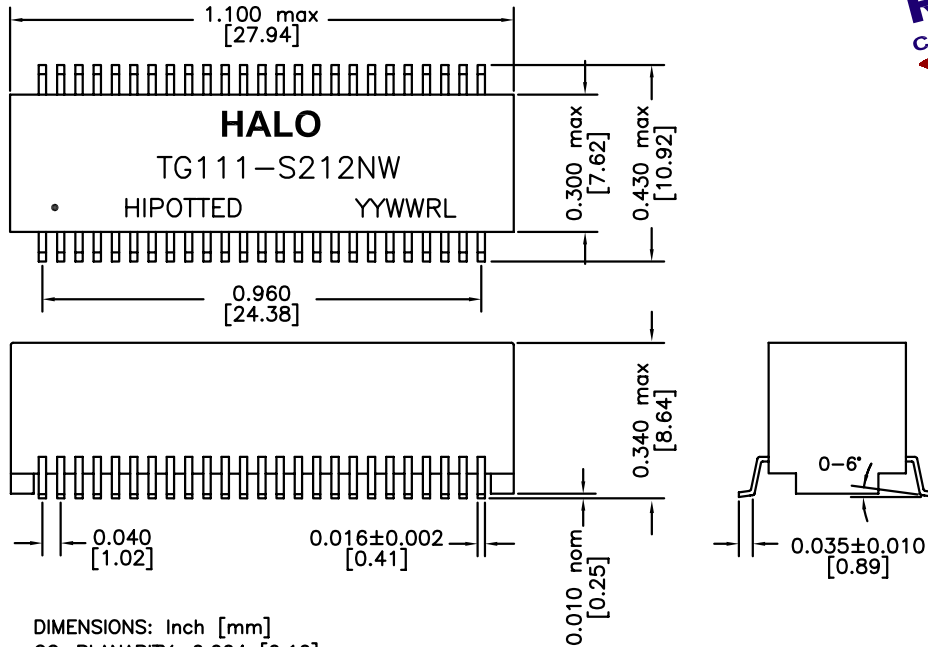
COMPATIBLE TO LEAD-FREE SOLDERING PROCESS CONDITION PER IPC/JEDEC J-STD-020C

UL/EN60950 AND DEMKO RECOGNIZED

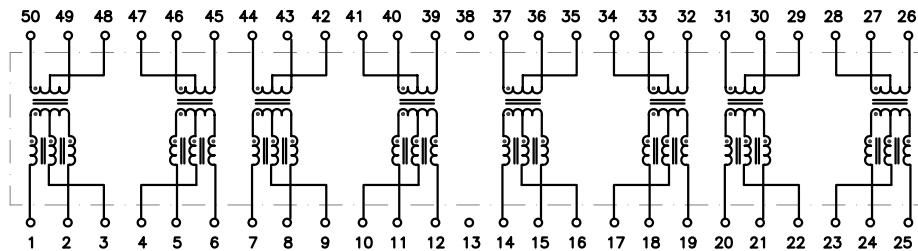
OPERATING TEMPERATURE 0/70°C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25° C

URNS RATIO	1CT:1CT±2%
OCL (100KHz,0.1Vrms,8mADC)	350µH min
INSERTION LOSS 1-100MHz	-1.1dB max
RETURN LOSS 1-40MHz	-18dB min
60MHz	-14dB min
80MHz	-12dB min
100MHz	-10dB min
CMR 1-100MHz	-40dB typ
CROSSTALK 1-30MHz	-50dB typ
60MHz	-45dB typ
100MHz	-40dB typ
ISOLATION	1,500Vrms



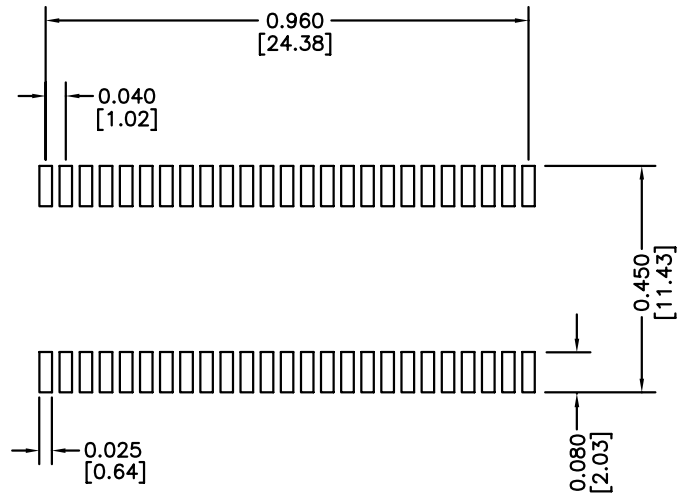
DIMENSIONS: Inch [mm]
 CO-PLANARITY: 0.004 [0.10]
 TOLERANCES: ±0.005 INCH IF NOT SPECIFIED



HALO/PBL

CALIFORNIA, USA
 KOWLOON, HONG KONG
 SINGAPORE

<p>TITLE ISOLATION MODULE</p> <p>FOR FAST/GIGABIT ETHERNET</p> <p>PART NO. TG111-S212NWRL</p> <p>SCALE NONE PAGE 1 OF 2</p>	SIGNATURES	DATE	REV.	DESC.	DATE
	DRAWN PETER LU	11/8/05	A	FIRST ISSUE	11/8/05
	CHECKED LEI KEONG	3/20/08	B	PROD. RELEASE	12/21/06
	APPROVED PETER LU	3/20/08	C	REV. TOE LENGTH TOL.	3/20/08
FILE S212NWRL.DWG					



RECOMMENDED SOLDER PAD DIMENSIONS
 DIMENSIONS: Inch [mm]

HALO/PBL	TITLE ISOLATION MODULE		SIGNATURES		DATE	REV.	DESC.	DATE
	FOR FAST/GIGABIT ETHERNET		DRAWN PETER LU		11/8/05	A	FIRST ISSUE	11/8/05
	PART NO. TG111-S212NWRL		CHECKED LEI KEONG		3/20/08	B	PROD. RELEASE	12/21/06
	SCALE NONE		APPROVED PETER LU		3/20/08	C	REV. TOE LENGTH TOL.	3/20/08
CALIFORNIA, USA KOWLOON, HONG KONG SINGAPORE	PAGE 2 OF 2	FILE S212NWRL.DWG						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9